

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】平成 17 年 8 月 25 日 (2005.8.25)

【公開番号】特開 2003-243780 (P2003-243780A)

【公開日】平成 15 年 8 月 29 日 (2003.8.29)

【出願番号】特願 2002-40957 (P2002-40957)

【国際特許分類第 7 版】

H 0 5 K 1/02

G 0 6 K 19/077

// H 0 1 L 23/12

【F I】

H 0 5 K 1/02 E

G 0 6 K 19/00 K

H 0 1 L 23/12 Q

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 2 月 17 日 (2005.2.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】配線基板及びそれを用いた電子装置、フラッシュカード

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

絶縁性基体の両面に金属膜の配線を形成した配線基板において、前記夫々の面に形成される配線の合計面積を近似させたことを特徴とする配線基板。

【請求項 2】

絶縁性基体の一方の面に銅箔を用いた信号パターンを形成し、他方の面に銅箔を用いた電源パターンを形成した配線基板において、前記電源パターンの残銅率と信号パターンの残銅率との相違を 10 % 以内としたことを特徴とする配線基板。

【請求項 3】

絶縁性基体の両面に配線を形成し、一方の面にコネクタを取り付けるコネクタ接続領域が設けられている配線基板において、前記コネクタ接続領域に対応する他方の面にレジストを形成しないことを特徴とする配線基板。

【請求項 4】

絶縁性基体の一方の面に銅箔を用いた信号パターンを形成し、他方の面に銅箔を用いた電源パターンを形成した配線基板を用いた電子装置において、前記電源パターンの残銅率と信号パターンの残銅率との相違を 10 % 以内とすることを特徴とする電子装置。

【請求項 5】

絶縁性基体の両面に配線を形成した配線基板の一方の面に設けられているコネクタ接続領域にコネクタが取り付けられる電子装置において、前記コネクタ接続領域に対応する配線基板の他方の面にレジストが形成されていないことを特徴とする電子装置。

【請求項 6】

ガラスエポキシを用いた絶縁性の板状基板と、

前記板状基板の一面に形成された、銅箔で構成された信号線用の信号パターン、前記信号線に接続されるコネクタ、及び前記コネクタは露出し、前記信号パターンは覆うように形成されたレジストパターンと、

前記板状基板の他面に形成された、前記信号パターンの残銅率との相違が10%以内である残銅率を有する電源線用の電源パターン、及び前記コネクタに対応する領域は除き前記電源パターンを覆うように形成されたレジストパターンと、

前記板状基板上に搭載されたメモリチップとを有するフラッシュカード。